

アプリケーション

弊社のカスタマイズされた DSP ソリューションは以下のような分野で使われております。:

- MEMS/MST 分野における DSP ソリューション
- マイクロ流体力学/フローセンサー
- RF MEMS
- 光エレクトロニクス

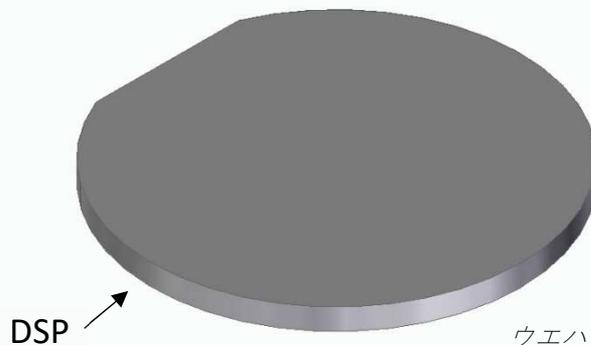
最終市場:

- テレコミュニケーション
- 医療
- 自動車
- 家電
- セキュリティ

アイスモスは 20 年以上の経験をもとに、ワールドクラスの DSP (Double Sided Polished) 両面ポリッシュのソリューションをお届けします。デザインや製造において長年の経験のある高い技術を持ったチームがお客様のご要望に合った DSP ソリューションをご提供します。

アイスモスの DSP ウエハーは両面にパターン転写ができる優れた基板です。アイスモスは製品やプロセスにおける専門知識や経験で厚みや面粗度のコントロールも可能で、理想的な張り合わせプロセスへと導きます。さらに標準的でない仕様に関するご検討可能です。

弊社の世界的クラスの製品品質と、コスト競争力を持ち、柔軟な対応でお客様の理想的な DSP のパートナーとなります。



ウエハーは酸化も必要に応じて対応できます。

DSP Specification

パラメーター	仕様 範囲	
ウエハー直径	100, 125, 150mm	200mm
ウエハー厚さ	300–1150 μm	450–1150 μm
ウエハー厚さ 公差範囲	$\pm 2 \mu\text{m}$	$\pm 5 \mu\text{m}$
厚さの偏差 (TTV)	$\leq 1 \mu\text{m}$	$\leq 2 \mu\text{m}$
Bow	$\leq 40 \mu\text{m}$	
Warp	$\leq 40 \mu\text{m}$	
粗さ	$\leq 2\text{\AA}$	
ドーパント タイプ	N or P	
ドーピング	N type: Phos, Red Phos, Sb & As P type: Boron	
抵抗率	$\leq 0.001 - \geq 10000 \Omega\text{-cm}$	
シリコン成長方法	CZ, MCZ or FZ	
結晶方位	$\langle 100 \rangle$, $\langle 111 \rangle$ or $\langle 110 \rangle$	
熱酸化 フィールド酸化膜厚	0.2–4.0 μm	

上記は標準の仕様ですが、特定の仕様のソリューションについて、喜んでお客様のご要望を検討させていただきます。
他のスペックなどお問合せなどがありましたら、セールsteamへコンタクトして下さい: sales@icemostech.com